

10101010101



新闻动态

- ▶ 图片新闻
- ▶ 头条新闻
- ▶ 综合新闻
- ▶ 学术活动
- ▶ 科研动态
- ▶ 通知公告
- ▶ 业内信息
- ▶ 合作交流

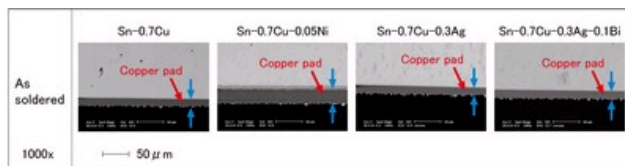
现在位置: 首页 > 新闻动态 > 业内信息

斯倍利亚突出展示低银和无银不含铅焊料之间的铜腐蚀差异

2011-11-30 | 编辑: | 【大 中 小】 【打印】 【关闭】

近日,日本斯倍利亚(Nihon Superior)有限公司突出展示其独特SN100C无铅焊料在回流焊接工艺中抑制铜腐蚀的更出色效果。针对目前市场上供应的各种低银和无银不含铅焊料的索赔和反索赔日益增多,这引起了Nihon Superior的关注。

如下显微照片来自昆士兰大学进行的一项研究,该研究旨在对比不同无铅焊料配方的铜腐蚀特性。熔融铜/有机保焊剂测试板在容器温度达255°C的情况下,在微波设备中接触焊料五秒钟。用Sn-0.7Cu-0.05Ni焊接的电路板上面残留的铜材料厚度大约是添加0.3Ag和0.3Ag+0.1Bi后焊接Sn-0.7Cu时残留铜材料厚度的两倍。



Sn-0.7、Cu-0.05Ni是日本斯倍利亚SN100C焊料的主成分,该焊料也添加Ge成分,作为抗氧化剂和助流剂。

关于日本斯倍利亚(Nihon Superior)公司

日本斯倍利亚公司成立于1966年,成立之初主要推销从美国进口的独特的助焊产品。之后,日本斯倍利亚公司因汇集来自世界各地的最先进的焊接产品和钎焊技术,在供应给金属连接行业的公司中树立了良好的口碑。随着日本斯倍利亚公司开始研发自己的焊接产品,并凭借其独特的SN100C无铅焊接合金,该公司已经成为全球市场的领导厂商。为了满足市场对其产品不断增长的需求,日本斯倍利亚公司已经在日本、亚洲和中国建立了制造和销售中心,并与多家海外企业建立了商业合作关系。

(来源: afinance 2011年11月29日)

附件下载: